

半導體設備漲價週期正式啟動，行業正從週期復蘇邁向盈利擴張新階段。近期全球存儲晶片產業掀起新一輪擴產熱潮，AI 驅動的 HBM 需求爆發成為核心引擎：三星電子、SK 海力士相繼上調先進制程與 HBM 產能規劃，美光也在全球多地推進大規模擴產專案，下游資本開支高景氣持續得到驗證。據伯恩斯坦研報，東京電子、Screen 等日本頭部設備廠商依託日元貶值的匯率紅利，疊加 AI 產業鏈的強勁需求拉動，已正式向下遊客戶發起提價，其中 SK 海力士已收到 3%-4% 的漲價訴求。若本輪漲價全面落地，設備廠商的毛利率與營業利潤率將迎來顯著增厚，板塊投資邏輯也將從前期的週期復蘇主線，正式切換至盈利擴張邏輯。花旗同步給出樂觀預測：2028 年全球晶圓廠設備市場規模將達到約 2500 億美元，並已上調應用材料 (AMAT.US)、泛林集團 (LRCX.US) 等美股半導體設備龍頭的目標價。在此產業趨勢下，國內半導體設備賽道有哪些核心個股值得重點佈局？

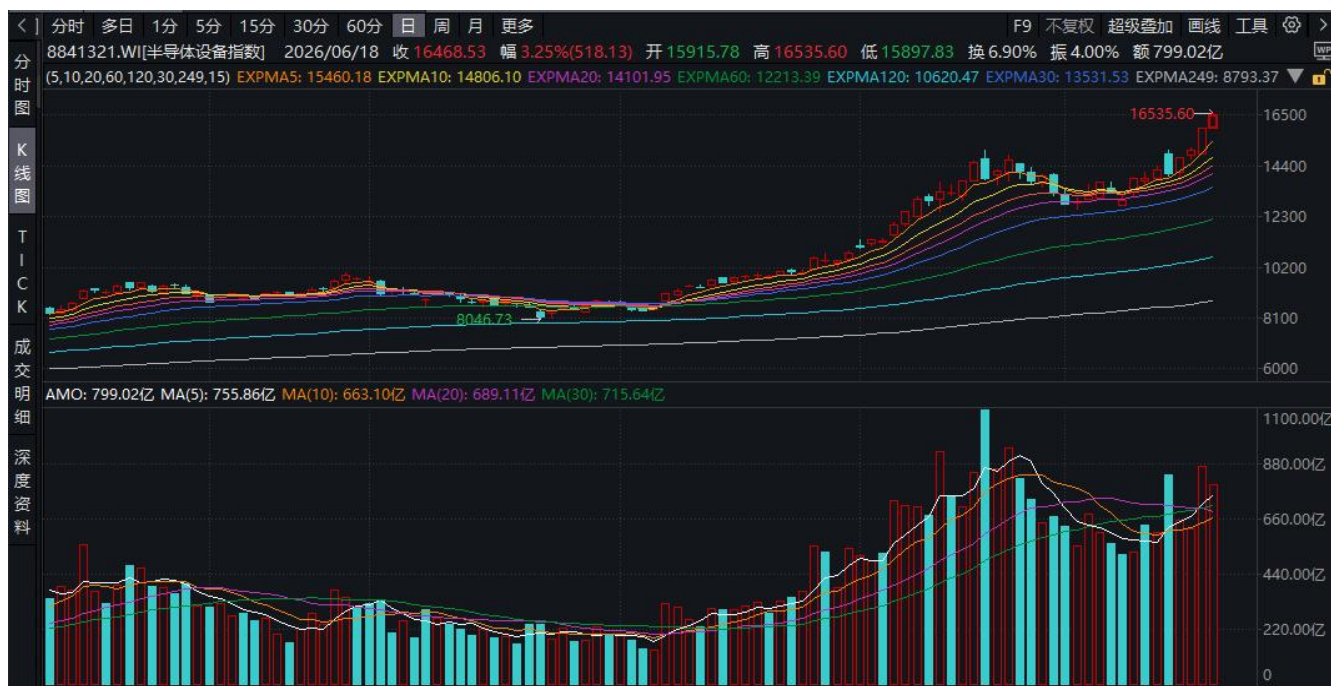
半導體設備漲價週期啟動，行業有望步入盈利擴張新階段

半導體設備行業正式開啟新一輪漲價週期。據伯恩斯坦最新研報確認，東京電子、Screen 等日本半導體設備龍頭已正式啟動提價策略，SK 海力士已收到 3%-4% 的漲價請求。本輪漲價由日元貶值、AI 需求爆發、行業供需格局偏緊三大因素共同驅動，是行業供需關係逆轉的明確信號。與此同時，行業長期成長空間也迎來大幅上修，花旗首次給出 2028 年全球晶圓廠設備 (WFE) 樂觀情景預測，市場規模將達到 2500 億美元，2026-2028 年分別為 1450 億、2000 億、2500 億美元，年複合增速超 30%，核心增長動力來自 Agentic AI 帶動的 NAND 存儲需求結構性爆發，以及全球晶圓廠的持續擴產浪潮。

伴隨漲價落地與需求放量，板塊投資邏輯正迎來關鍵切換，主線將從前期的“週期復蘇預期”轉向“盈利擴張兌現”。若本輪漲價順利落地，設備廠商的毛利率與營業利潤率將迎來顯著提升，疊加下游需求持續放量，行業將正式進入“量價齊升”的戴維斯雙擊階段。對於國內設備廠商而言，海外設備漲價與交期拉長將進一步加速國產替代進程，國內具備核心技術壁壘、已進入主流產線驗證的設備廠商將迎來訂單與盈利的雙重提升，建議重點佈局平臺型龍頭與細分賽道隱形冠軍。



圖一：國內半導體設備指數行情情況



資料來源：Wind

➤ 漲價週期啟動：供需格局逆轉，設備廠商提價

*漲價核心驅動：供需格局變化

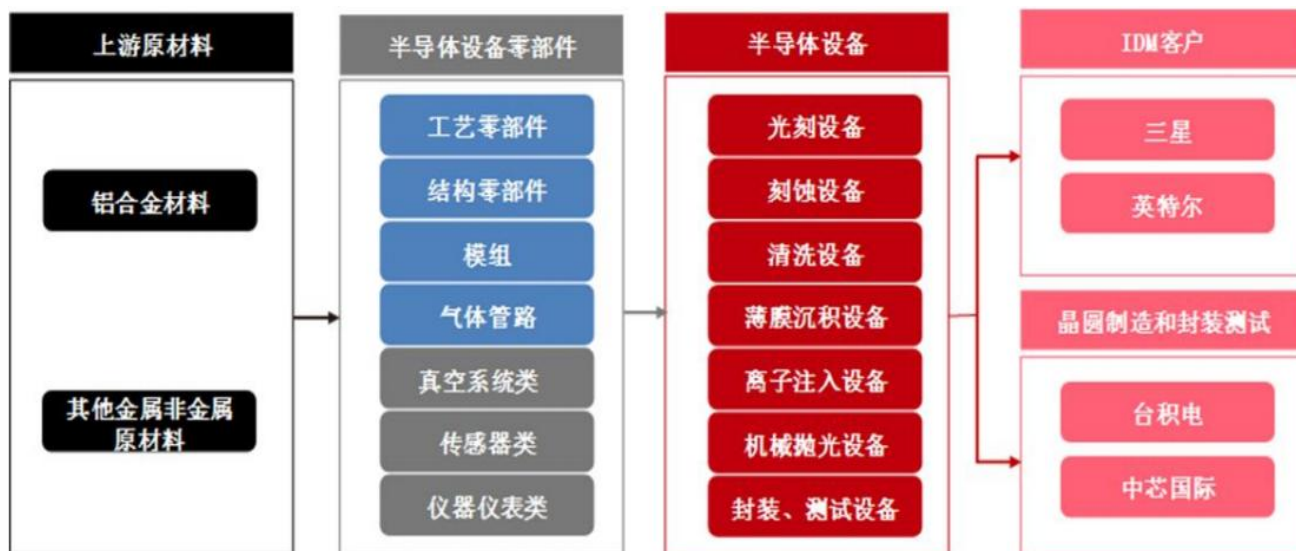
需求端來看，AI 產業的超預期爆發正成為半導體設備需求增長的核心引擎，其中 Agentic AI (智能體 AI) 的快速落地，正在引發 NAND 閃存需求的結構性躍升。不同於傳統大模型的單次推理，智能體的多步驟推理、工具調用與自主決策工作流，會大幅放大鍵值緩存的容量需求；同時企業級 SSD 正從傳統的被動存儲載體，逐步轉向承擔大模型主動推理緩存層的核心角色，這一定位質變直接推高了雲端與企業級市場的存儲採購規模。受此驅動，三星、SK 海力士、美光三大全球存儲巨頭紛紛上調 2026-2027 年的資本開支計畫，加速 NAND 閃存與 HBM 高帶寬存儲的產能擴張。與此同時，先進制程邏輯晶片的擴產節奏也在加快，臺積電 2nm、1.4nm 產線建設持續提速，全球晶圓廠為搶佔 AI 晶片產能份額紛紛提前鎖定設備產能，下游搶單現象持續加劇，全產業鏈的設備採購需求持續超出市場預期。

供給端則持續呈現產能緊繃、交付週期拉長的緊張格局，供需錯配態勢進一步加劇。當前全球主流半導體設備廠商已全面進入滿負荷生產狀態，東京電子已將旗下所有生產基地從單班制切換為雙班制全力趕產，應用材料、泛林集團等龍頭也均處於產能滿載狀態，但核心設備的交付週期仍持續拉長：刻蝕、薄膜沉積等通用核心設備交期已拉長至 5-8 個月，高端 EUV 配套設備、高精度檢測設備等技術壁壘較高的細分品類，交付週期更是超過 12 個月。供給彈性不足的背後，一方面是半導體設備產業



鏈條冗長，核心精密零部件如真空腔體、光學鏡頭、高精度控制閥的擴產週期長達 18-24 個月，上游產能難以快速回應下游需求爆發；另一方面，設備研發與裝配高度依賴資深技術人才，行業專業人才供給缺口顯著，進一步限制了產能爬坡速度。供需格局的持續收緊，也直接賦予了設備廠商較強的定價話語權，為行業開啟漲價週期奠定了堅實基礎。

圖二：半導體設備產業鏈



資料來源：上市公司富創精密招股說明書

*海外廠商漲價動態：從意向走向落地

據伯恩斯坦最新產業調研顯示，日本頭部半導體設備商已制定清晰明確的提價路徑，相關價格談判正全面進入實質落地階段。其中東京電子將定價體系優化列為首要戰略目標，採用分三步走的漸進式提價策略：一是針對當前供需緊張下的加急訂單收取專項溢價費用，匹配緊急交付的額外產能成本；二是向下遊客戶逐步傳導原材料、人工及物流等通脹帶來的成本上漲壓力；三是在下一代高端新機型推向市場時，依託技術升級與性能迭代大幅抬高產品定價基準。公司目標將長期毛利率提升至 50% 以上，營業利潤率向 35% 靠近，這一盈利水準顯著高於當前市場一致預期。

另一家日本設備龍頭 Screen Holdings 則推進兩階段提價計畫，第一階段針對通脹因素的成本傳導方案已獲得下游客戶普遍接受，第二階段正圍繞新機型的技術附加值與性能升級開展漲價談判，公司長期營業利潤率目標設定為 30%。行業層面也已出現明確驗證信號，SK 海力士已正式收到設備供應商發出 3%-4% 的漲價請求，這標誌著本輪漲價已從設備廠商的戰略規劃，正式傳導至客戶端的商務談判環節，漲價落地的市場概率大幅提升，也進一步印證了行業供需格局的持續收緊。

漲價浪潮並非日本市場獨有，全球半導體設備行業正形成普漲態勢。應用材料(AMAT.US)、泛林集團(LRCX.US)等美國頭部設備廠商也在 2026 年二季度陸續上調部分設備報價，其中高端刻蝕、薄膜沉



積設備等緊缺品類漲幅達 15%-30%。從日本廠商的漸進式提價到美國廠商的高端產品大幅調價，本質上均是 AI 驅動下設備需求爆發、供給產能緊繃的共同結果，全行業性的漲價週期已基本確立，設備廠商的盈利擴張邏輯也將逐步兌現。

► 行業空間展望：AI 驅動長景氣，2028 年有望達 2500 億美元

花旗在最新研報中上調全球晶圓廠設備 (WFE) 行業規模預期，首次給出 2028 年市場規模測算。樂觀情景下，2026 年全球 WFE 市場規模可達 1450 億美元，2027 年增至 2000 億美元，同比漲幅 37.9%，2028 年進一步攀升至 2500 億美元，同比增長 25%；即便參考中性預測，2028 年行業規模也能達到 1930 億美元，兩次情景下的數據均明顯超出此前市場一致預判，充分印證半導體設備行業向上的成長空間。

本輪半導體設備景氣週期和以往週期性復蘇有著本質差異，在 AI 產業賦能下，行業增長具備更強持續性與結構性特徵。首先存儲行業需求邏輯發生根本性轉變，過去存儲廠商擴產多跟隨消費電子週期起伏，如今由 AI 算力拉動，HBM、高端 DRAM、3D NAND 進入長期擴產階段，三星、SK 海力士、美光持續加碼資本開支，美光更是將 2026 財年淨資本支出從 200 億美元上調至 250 億美元以上。與此同時，頭部晶圓代工廠不斷加碼先進制程產能佈局，臺積電、三星、英特爾持續加大建廠投入，花旗測算顯示臺積電 2027、2028 年資本支出分別為 670 億美元、750 億美元，英特爾 2027 年資本開支增速預計可達 36%，大幅超越市場前期預期。

AI 算力建設帶來的資本開支熱潮自上而下傳導至整條半導體產業鏈。全球頭部雲廠商未來三年資本開支維持高速增長，機構預計 2026 至 2028 年增速分別為 84%、56%、38%。各大雲企業大規模佈局 AI 算力基礎設施，直接催生海量高端晶片設計需求，倒逼全球晶圓廠持續擴產新建產線，最終轉化為大量半導體設備採購訂單，形成“雲廠商資本投入—高端晶片需求釋放—晶圓廠擴產落地—設備訂單持續放量”的完整傳導鏈路，為 WFE 行業高景氣提供長期穩固支撐。

圖三：海外主要大廠資本開支指引上調

科技巨頭	最新更新開支計畫 (億美元)		原計畫 (億美元)	變動 情況
亞馬遜	2025	1250	1000	上調
微軟	2026Q1	349	330	上調
穀歌	2025	910-930	850	上調
Meta	2025	700-720	690	上調

資料來源：ifind



► 國內半導體設備賽道有哪些核心個股值得重點佈局？

2026 年初半導體設備板塊此前的上漲主要依託行業週期觸底復蘇的預期，行情以估值修復為主，市場博弈訂單與營收回暖，企業盈利尚未迎來明確拐點；而隨著海外設備廠商漲價信號陸續落地，板塊投資邏輯正式切換至盈利兌現階段，本輪提價將直接增厚企業毛利率與營業利潤率，盈利彈性顯著高於營收增速，疊加下游 AI 帶動的設備需求持續放量，行業正式邁入量價齊升的盈利擴張階段，業績增速將大幅跑贏營收增速，同時 AI 催生的長期結構性需求能夠平滑行業傳統週期性波動，行業成長屬性持續強化，估值中樞具備系統性上移空間，除此之外，海外設備漲價、交付週期拉長也為國內設備廠商創造發展機遇，海內外產品價差收窄提升國產設備性價比，下游晶圓廠出於穩定產能的需求會加速導入國產設備，進一步推動行業國產替代提速。

當前可重點佈局平臺型全能龍頭、各細分賽道設備冠軍以及核心零部件優質企業，全產業鏈充分受益本輪行業漲價與盈利擴張週期。平臺型龍頭方面，北方華創(002371.SZ)是國內稀缺的全工序覆蓋半導體設備企業，產品涵蓋刻蝕、PVD、CVD、清洗、熱處理等絕大多數晶圓製造核心環節，多品類設備實現規模化批量交付，深度綁定國內外頭部晶圓廠，訂單能見度已延伸至 2027 年，是行業景氣度提升的核心核心受益標的。

測試設備領域，華峰測控 (688200.SH) 是國內模擬及混合信號測試機龍頭，國產化率領先行業，高端測試設備持續迭代突破，全面受益於晶圓製造、封測產能規模化擴張。長川科技(300604.SZ)實現測試機與分選機雙輪驅動，數字測試機完成關鍵技術突破，同時斬獲國內外大量封測廠訂單，成長動能充足。在半導體設備核心控制環節，上海復旦(1385.HK)作為國內優質 FPGA 晶片企業，其產品廣泛應用於半導體設備核心控制環節，是國產半導體設備產業鏈的關鍵上游配套標的，伴隨國內設備廠商規模化放量，公司晶片產品需求持續攀升，業績增長確定性較強。在晶圓製造環節，中芯國際(0981.HK)作為國內晶圓製造龍頭，持續加碼成熟制程與先進制程產能擴建，資本開支維持高位，既是國內半導體設備廠商的核心下游客戶，自身產能擴張也將持續拉動設備採購需求，同時充分受益於行業整體盈利改善與景氣上行。

免責聲明：本報內容所提供資料所述或與其相關的任何投資或潛在交易，均受限於閣下司法轄區適用的法律及監管規定，而閣下須單獨遵守該等法律及監管規定負責。本報內容僅供參考，不構成任何投資建議。本公司對所提供的財經資訊已力求準確，但對其中全部或部分內容的準確性、完整性或有效性，不承擔任何責任或提供任何形式保證。如有錯失遺漏，本公司恕不負責。另請注意證券與虛擬資產價格可升可跌，尤其虛擬資產的風險極高，投資者應對有關產品保持審慎及自行承擔投資風險。

